

No. : 5/IMDIA/II/10

Hal : Pelaksanaan Seminar IMDIA bulan Februari

Kepada Yth.

Seluruh anggota IMDIA

Dengan hormat,

Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada IMDIA.

Komite Teknologi IMDIA dengan dukungan dari Komatsu Industries akan mengadakan seminar teknologi mengenai teknologi terbaru dalam Press Stamping ukuran besar, yang mana seminar ini merupakan seminar ke-5 dalam rangkaian seminar Mold & Dies ukuran besar serta presisi. Untuk itu kami mohon kedatangannya dalam seminar ini.

1. Tujuan : Seminar ini akan membicarakan mengenai konstruksi, fungsi, kemampuan, spesifikasi die, serta contoh-contoh penggunaan mesin Servo Press ukuran besar dan kecil, yang mana dengan memperkenalkan teknologi Press Stamping ukuran besar terbaru di Jepang ini, diharapkan dapat memahami perubahan trend yang nantinya akan terjadi dalam Stamping Press di masa datang, dan menjadikannya sebagai
2. Target peserta : Designer, procurement, penanggung jawab mold/die, tenaga ahli teknik Stamping Press.
3. Waktu : **Kamis, 25 Februari 2010 pukul 14:00 - 16:00**
4. Tempat : **YPMG Auditorium**
Graha Manajemen YPMG, Kompleks PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 29 Jakarta Timur 13710
5. Tema : **Teknologi Terbaru Servo Press serta Contoh Penggunaanya**
6. Pembicara : **Mr. Masahide Sunata & Mr. Norihisa Okamoto(Komatsu Industries Co.,Ltd)**
7. Biaya : **Gratis (Non member Rp 50,000)**

Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi seluruh anggota IMDIA.

Dikarenakan keterbatasan tempat, maka tiap corporate member diperkenankan mengirimkan maksimal 3 partisipan saja. Dalam seminar disiapkan interpreter yang akan menterjemahkan dari bahasa Jepang kedalam bahasa Indonesia.

Terima kasih.

Jakarta, 5 Februari 2010

Ketua Indonesia Mold & Dies Industry Association

Makoto Takahashi

Ikut Seminar Tidak ikut seminar

Balasan:

Re-Fax No. 021-871-7864

Re-email Ms. Novianti (novianti@imdia.or.id)

(Apabila ikut berpartisipasi silahkan isi formulir dibawah)

Nama Perusahaan :
(Nama Anggota) (Untuk individual member tidak dapat diwakilkan)

Nama peserta :

:

:

Kami mengharapkan balasan melalui e-mail maupun fax selambat-lambatnya hari Senin, 22 Februari 2010, pukul 12:00 WIB